
南亞電路板股份有限公司 2022年營運概況

2023年03月07日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

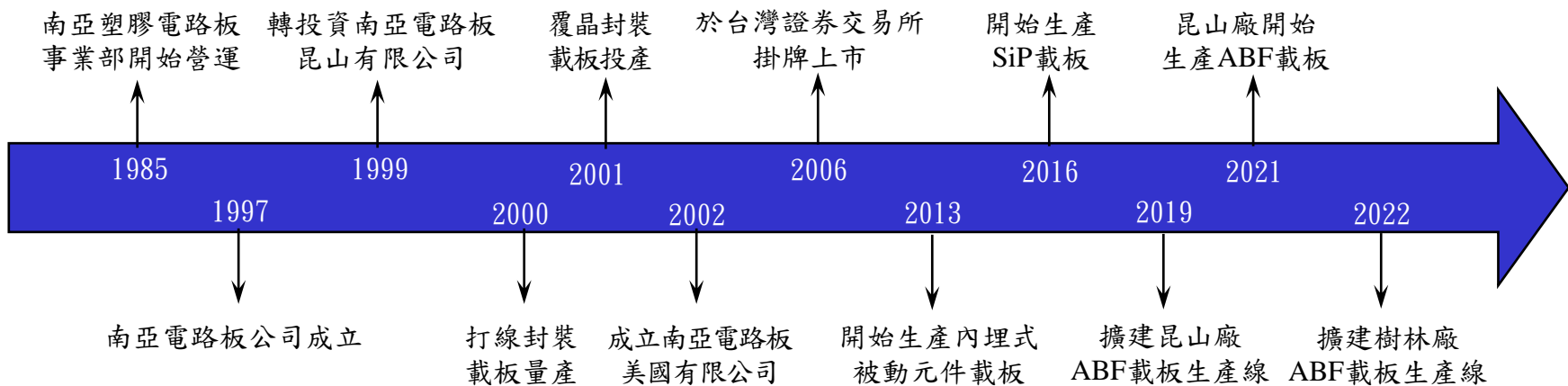
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2022年合併營業額為新台幣 646.5億元。
- 台股上市市值：新台幣1,446.8億元(2022年12月31日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板
- 2022 : 樹林廠開始生產ABF載板



財務狀況

近三年合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

■ 年成長率

2020年

2021年

2022年

38,512.7

52,228.5

64,646.8

+35.6%

+23.8%

■ 2021年營收較2020年增加35.6%:

本公司因遠距商務、居家娛樂等應用產品需求提升，營運績效持續改善，2021年營收比2020年顯著成長。

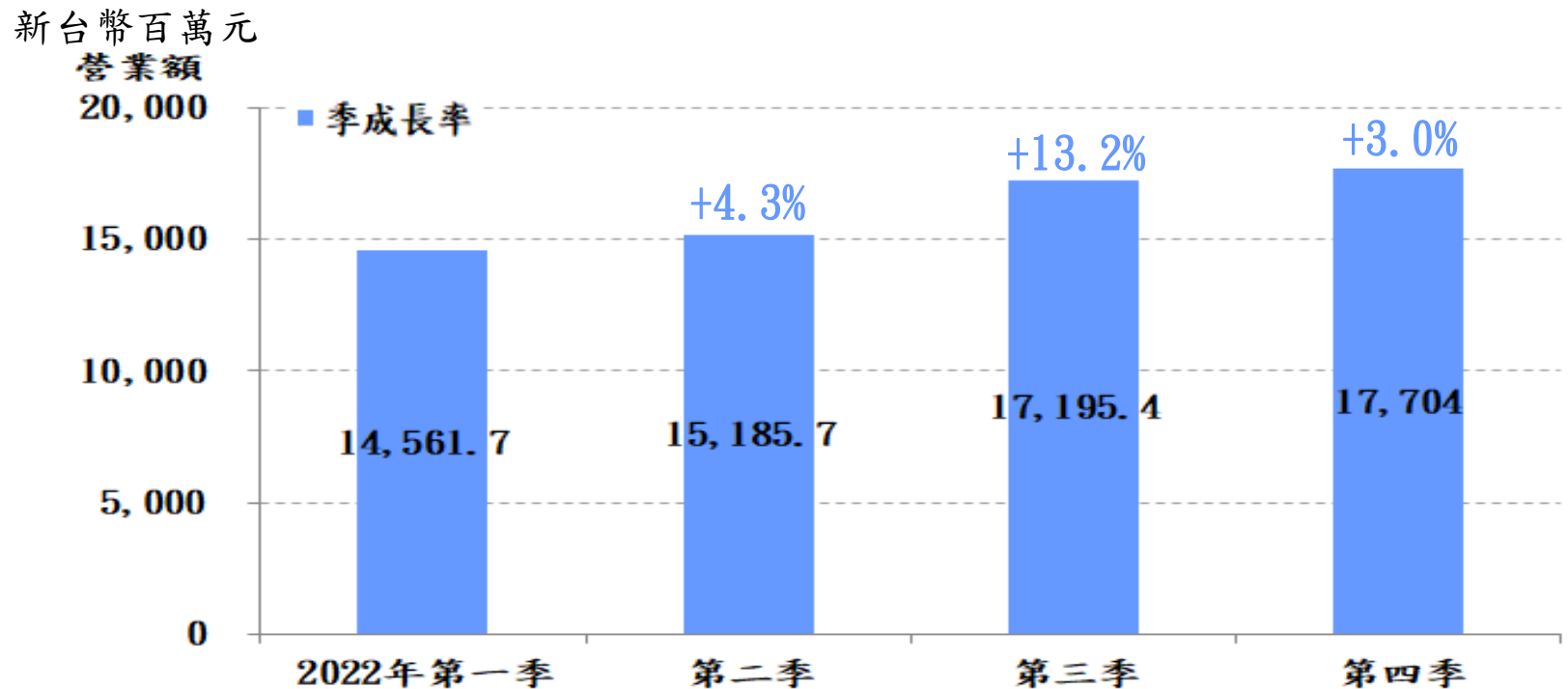
■ 2022年營收較2021年增加23.8%:

本公司因量產5奈米電腦處理器與系統級封裝應用載板，高值化產品銷售增加，2022年營收比2021年再成長。



財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)



■ 2022年第二季營收較2022年第一季增加4.3%:

第二季因高值化產品銷售持續成長，抵銷4月昆山廠靜態管理與5月台灣疫情影響，營收比第一季成長。

■ 2022年第三季營收較2022年第二季增加13.2%:

第三季受益於5奈米電腦處理器應用載板等高值化產品量產，營收比第二季顯著提高。

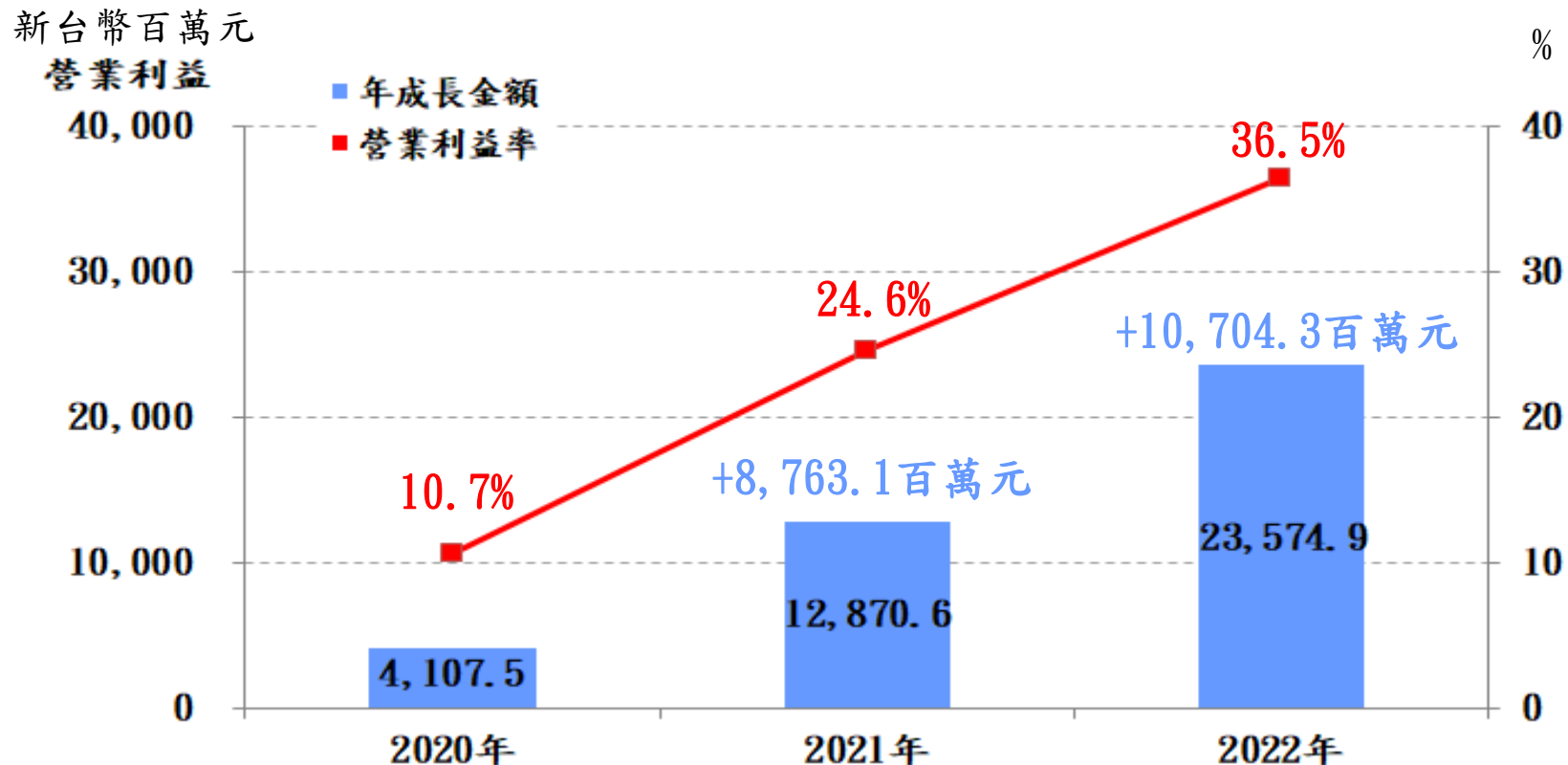
■ 2022年第四季營收較2022年第三季增加3.0%:

第四季因大尺寸高層數產品銷售再提高，營收比第三季再成長。



財務狀況

近三年營業利益



■ 2021年營業利益較2020年增加8,763.1百萬元:

除高值化產品銷售增加與IC載板新產能貢獻外，亦持續將人工智慧導入生產管理，優化製程，營業利益持續提升。

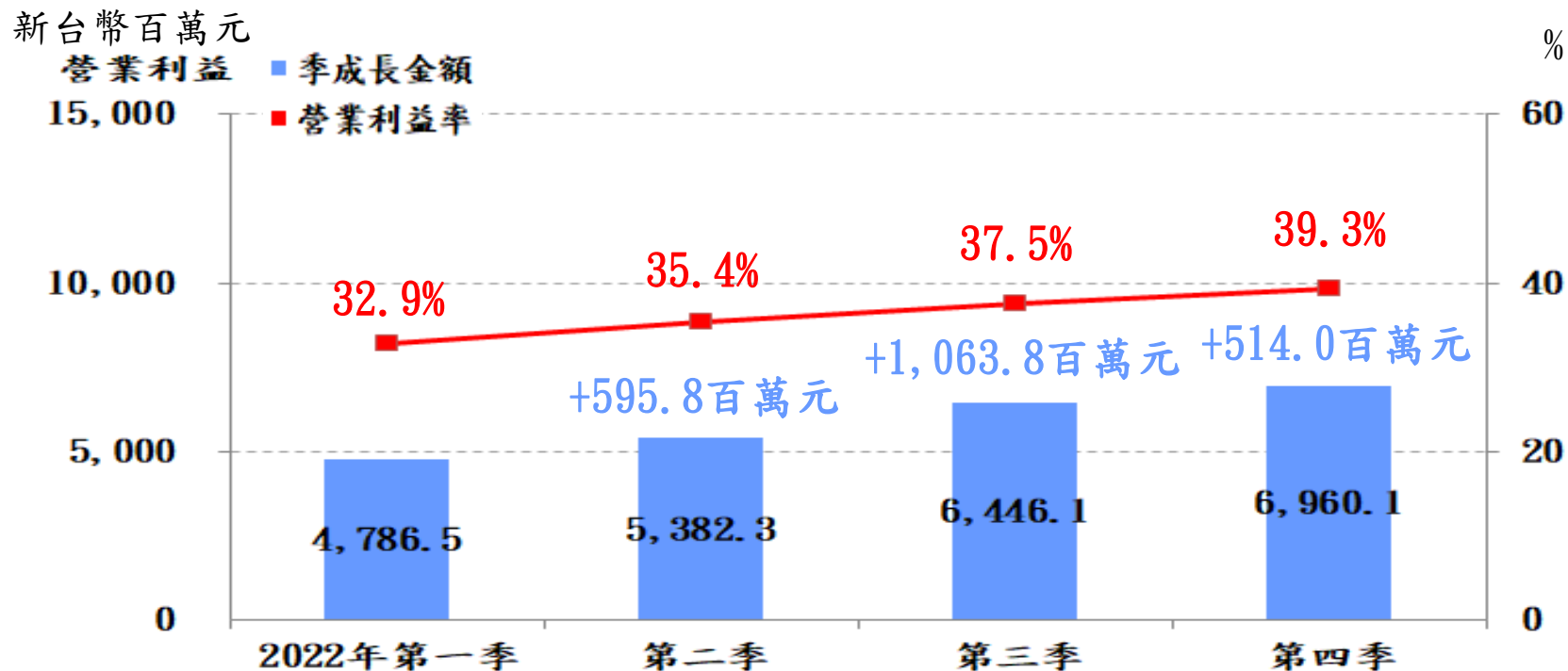
■ 2022年營業利益較2021年增加10,704.3百萬元:

本公司針對高階IC載板製程去瓶頸，增加產出，且大尺寸高層數IC載板等高值化產品銷售提高，營業利益再成長。



財務狀況

近一年每季營業利益

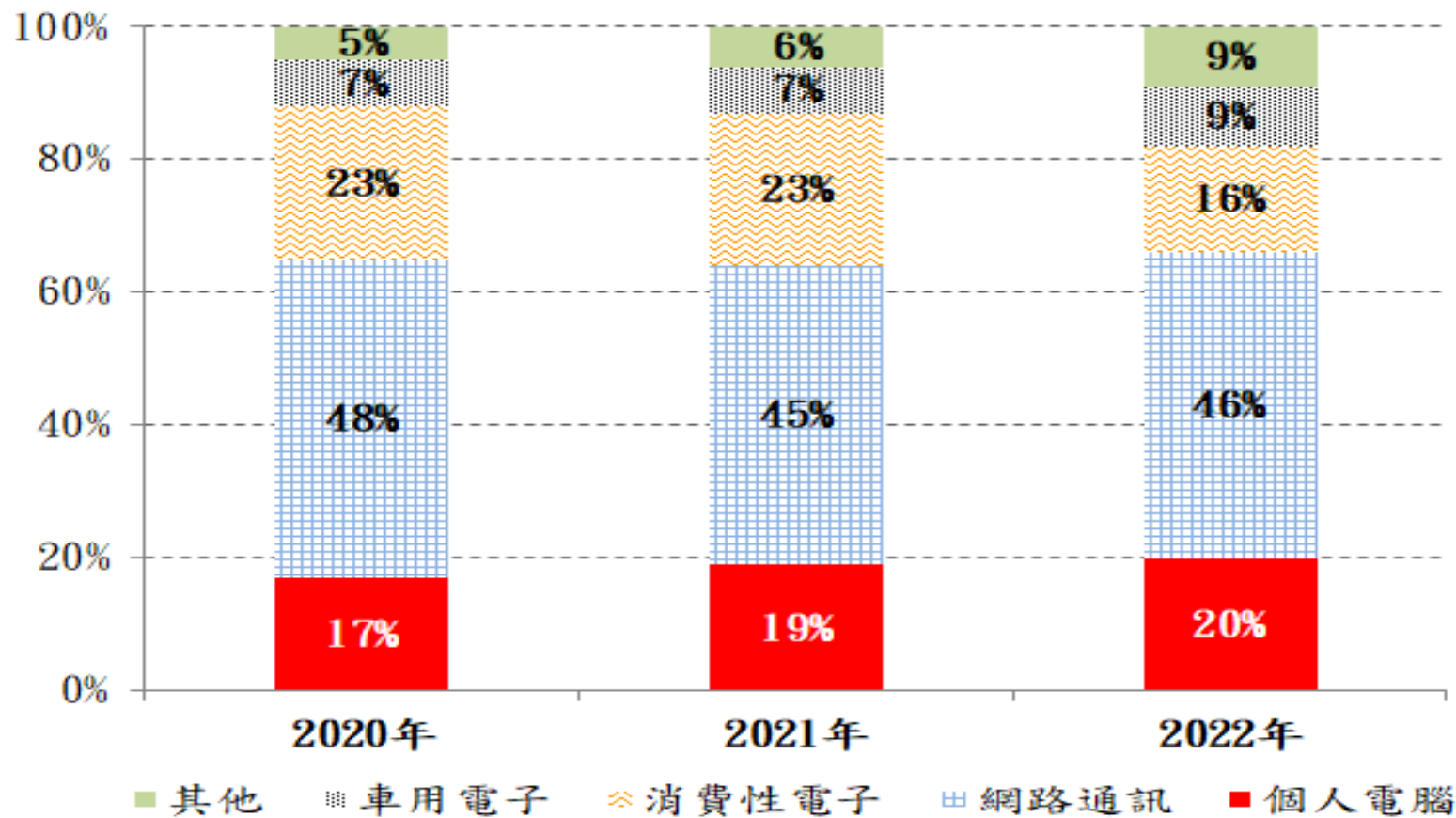


- 2022年第二季營業利益較2022年第一季增加595.8百萬元：
本公司除大尺寸高層數高階IC載板銷售增加外，並導入數位管理、人工智慧改善生產良率與效率，使獲利持續成長。
- 2022年第三季營業利益較2022年第二季增加1,063.8百萬元：
下半年起開始量產5奈米電腦處理器，第三季獲利比第二季再成長。
- 2022年第四季營業利益較2022年第三季增加514.0百萬元：
大尺寸高層數IC載板銷售持續成長，進一步提升本公司獲利。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

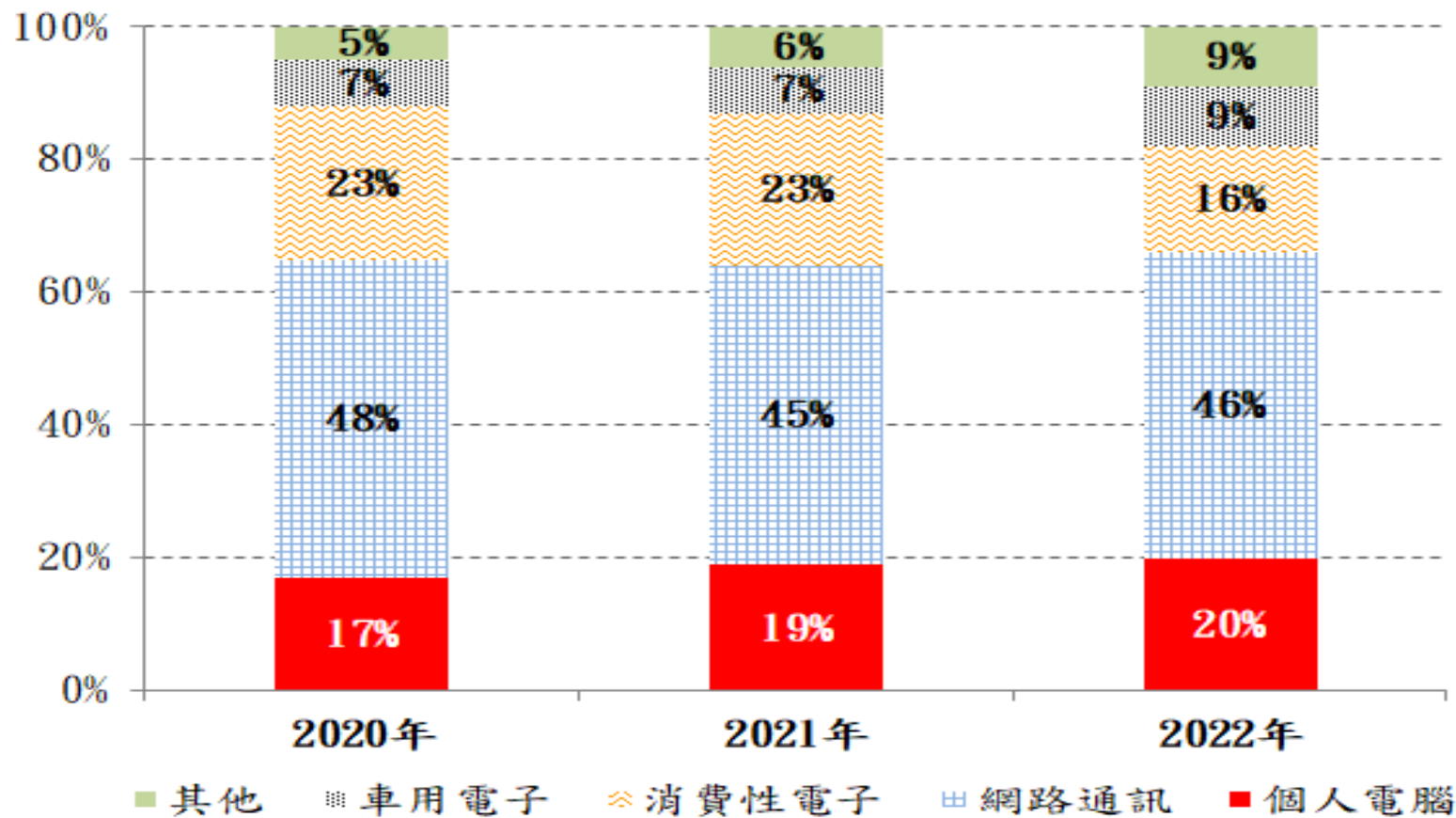


- 本公司因客戶推出5奈米電腦處理器，市占率提升，且高階網通設備需求回溫，2022年個人電腦與網通營收比重提高。
- 受通貨膨脹與消費型態改變影響，消費性電子產品訂單減少，2022年相關營收比重下滑。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 因電動車銷售增加，且汽車採用更多電子設備，帶動車用電路板需求成長，2022年車用電子營收比重增加。
- 本公司積極爭取更多資料中心與邊緣運算商機，大尺寸高層數IC載板銷售增加，2022年相關營收比重再成長。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ ABF載板

將與客戶緊密合作，持續開發5奈米電腦處理器、伺服器處理器、網通交換器晶片及4奈米遊戲機處理器應用載板，樹林廠一期、昆山廠二期的新產能於第一季全能生產，並致力於樹林廠二期提前量產，提高高值化產品生產量。

■ BT載板

針對IC異質晶片封裝發展趨勢，本公司將開發新世代行動裝置中各類應用(通訊、位移感知、生物感知等)的系統級封裝載板，並積極因應資料中心與5G通訊需求，將量產5G光通訊收發模組、高階訊號轉換器及5G毫米波天線應用產品。

■ 一般電路板

消費性及車用電子等產品設計愈趨精密，中介板、HDI等產品需求提高，本公司2023年將量產新世代5G手機中介板、高階電腦主機板、新世代顯示卡、LED燈珠及工業用無人車應用產品，以優化產品組合。



未來營運目標

公司營運維持高度競爭力

- 培養優秀的研發與製程技術人才，強化研究開發量能，以開發新材料與新技術，提升生產能力與良率，並增加產品附加價值。
- 參與客戶設計，共同開發及提供原生數據，分享生產資訊，縮短交期。
- 持續針對2.5D/3D先進封裝趨勢發展，開發更多高階IC載板，以提升高值化產品銷售比重。
- 持續將人工智慧導入營運管理模式，推動智能化生產，並優化製程條件與設備效能，以軟硬並進的策略，提升良率與效率。
- 因應美中半導體不同陣營發展，依計畫擴建兩岸高階IC載板產能，增加高值化產品產量，維持公司競爭力。
- 持續推動ESG專案，訂定國際科學基礎減碳目標，落實企業社會責任。
 - 2022年完成減碳8,927噸CO₂e/年，及每日節電24,895度。
 - 持續推動減碳專案，並於2023年建置太陽能發電系統，預計每年減碳334噸CO₂e/年。
 - 致力於達成2020年~2030年溫室氣體排放量減碳25%。



感謝您的聆聽

